

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 晶方科技关于董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **高送转议案的主要内容：**拟以公司2021年12月31日公司的总股本408,077,716股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.83元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转至下一年度。
- **公司董事会关于高送转议案的审议结果：**公司第四届董事会第六次会议审议通过了2021年度利润分配预案的议案。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
- **本年度现金分红比例低于30%的原因：**公司结合所处行业特点以及自身发展阶段，2022年需投入大量资金用于产品研发创新、扩大产能建设，需留存充足收益用于流动周转及未来发展。

### 一、高送转议案的主要内容

公司于2022年4月8日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，具体内容为：

（一）以截至2021年12月31日公司的总股本408,077,716股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.83元（含税），合计派发现金股利人民币115,485,993.63元，占公司当年实现的归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%。

（二）以截至2021年12月31日公司总股本408,077,716股为基数，公司拟

以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次送、转股后，公司的总股本增加至 652,924,346 股。

### （三）本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 576,048,107.03 元，2021 年拟分配的现金红利总额为 115,485,993.63 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要基于以下因素：

#### 1、公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

#### 2、公司发展阶段

公司目前处于扩张成长阶段，专注于集成电路传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。随着 5G、AI、算力算法的趋势性发展与提升，以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富，推动手机多摄像头应用渗透率持续提升、安防监控数码市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起，公司封装产品的行业与市场景气度显著提升。为抓住传感器领域的市场机遇，公司正在实施“集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目”的建设，通过技术工艺升级提升，产能扩充，满足市场与客户的创新需求，该项目的有序建设，推动公司有效把握了手机、安防监控数码市场快速发展机遇，并在汽车电子领域实现了量产，后续将根据市场的增长情况，对工艺与产能进行持续的布局与提升。

#### 3、公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------------------	----------------------

					润	利润的比率 (%)
2021年	3	2.83	3	115,485,993.63	576,048,107.03	20.05
2020年	1	2.35	1	79,746,019.54	381,616,747.13	20.90
2019年	2	1.00	2	22,967,945.5	108,304,952.46	21.21

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

#### 4、公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

①产业链延伸拓展。持续开展国际化并购整合，推进产业链的延伸拓展。2021年公司收购晶方产业基金股权，实现对晶方光电及荷兰 Anteryon 的股权控制，进一步加强业务与技术的互补融合，一方面推进 Anteryon 公司的光学设计与混合光学镜头业务的稳步增长，盈利能力不断增强。同时有效提升晶方光电晶圆级微型光学器件制造技术的工艺、量产能力，开始实现商业化规模应用。参与投资以色列 VisIC 公司，积极布局车用高功率氮化镓技术，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。参与共建“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所”，充分利用政府、产研院等共建方的资源支持，通过引入、孵化与培育研发团队，对车规半导体新工艺、新材料、新设备展开研发与战略布局，以车电半导体需求为聚焦点构建产业生态链，以期能更好把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新发展机遇。国际化的并购整合与产业链拓展延伸，需要相应的资金储备与能力，才能快速抓住行业出现的新机会。

②持续加强研发投入。公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2019年、2020年及2021年公司的研发费用分别达

123,202,937.94 元、137,260,099.21 元、172,623,162.92 元，2022 年公司仍需保持对研发的持续投入，通过对技术、工艺的持续创新开发，顺应并把握不断变化的市场需求。

③满足业务规模持续增长的营运资金需要。随着公司资产、业务及生产规模的发展，公司的营运资金投入也会相应有所增长。2021 年公司实现营收规模为 1,411,173,857.40 元，同比增长 27.88%，2022 年随着公司在车载摄像头、汽车微型光学器件等应用领域量产规模的提升、募投项目建设及产能规模的不断扩大、生产效率的持续提升，公司业务规模将保持快速增长，从而将使得公司经营所需营运资金规模也相应会增加。

因此，公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展、研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

## 二、 董事会审议高送转议案的情况

### （一）董事会审议高送转议案的表决结果

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）本次高送转方案的合理性和可行性

截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民币 1,448,499,584.74 元，期末资本公积余额为 1,826,189,922.69 元，公司可供分配利润、资本公积金充足，具备本次以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的实施基础。

公司近两年主营业务持续增长，盈利能力不断提升，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司近 3 年的经营业绩情况如下：

单位：人民币元

	2019 年度	2020 年度	2021 年度
主营业务收入	560,367,354.58	1,103,528,757.63	1,411,173,857.40
归属于上市公司股东的净利润	108,304,952.46	381,616,747.13	576,048,107.03
基本每股收益	0.33	1.19	1.41

公司净利润持续增长，最近两年净利润的复合增长率为 131%，符合有关实

施高送转的相关规定与条件，且公司也不存在不得披露高送转方案的相关情形。

本次通过以未分配利润、资本公积向全体股东送、转股份的预案，与公司业务经营的增长情况匹配，通过股本规模的有效扩大，一方面有利于公司更好把握行业与市场的发展机遇，推动公司业务规模的持续增长，另一方面有利于进一步优化公司股本结构，提高公司股票流动性，提升广大投资者对公司持续发展的信心。

公司独立董事认为：公司提出的 2021 年度利润分配及送转股预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次分配预案并将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、公司第一大股东及持有公司股份的董事的表决意向**

经征询，公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司以及持有公司股份的董事拟在公司 2021 年年度股东大会审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》时投同意票。

### **四、公司第一大股东及董事、监事、高级管理人员的权益持股变化**

经征询，公司董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之前 3 个月内无持股变动。公司第一大股东在董事会审议高送转事项之前 3 个月内也无持股变动。

公司董事、监事、高级管理人员自董事会审议高送转事项之日起未来 6 个月内无增减持公司股票的计划，除参加股权激励认购公司股份的情形之外。公司第一大股东目前也没有增减持公司股票的计划。

### **五、相关风险提示**

（一）本次高送转议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）公司在董事会审议通过高送转议案前后的 6 个月，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况（员工股权激励限售解禁除外）。

（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产

等指标将相应摊薄。

（四）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年4月9日